经营者集中简易案件公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 | 立讯精密工业股份有限公司收购威讯联合半导体（新加坡）有限公司等两家公司股权案 |
| 交易概况（限200字内） | 立讯精密工业股份有限公司（“**立讯精密**”）拟从威讯联合半导体有限公司（“**威讯联合半导体**”）收购威讯联合半导体（新加坡）有限公司（“**威讯新加坡**”）和威讯联合半导体（香港）有限公司（“**威讯香港**”）的100%股权（“**本次交易**”）。威讯新加坡和威讯香港为控股公司，分别持有威讯联合半导体（德州）有限公司（“**威讯德州**”）和威讯联合半导体（北京）有限公司（“**威讯北京**”，与威讯新加坡、威讯香港和威讯德州合称为“**目标公司**”）100%的股权。交易前，目标公司由威讯联合半导体间接全资拥有并单独控制。交易完成后，立讯精密将全资拥有并单独控制目标公司。 |
| 参与集中的经营者简介（每个限100字以内） | 1.立讯精密 | 立讯精密于2004年5月24成立于广东省深圳市。立讯精密主要业务为研发、制造及销售各种零件、模组和系统，产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。立讯精密的最终控制人为自然人，其通过立讯精密开展上述业务。 |
| 2. 目标公司 | 威讯新加坡于2013年10月23日在新加坡成立。威讯香港于2007年10月30日在中国香港成立。威讯德州和威讯北京主要业务为在中国运营两家半导体封装测试工厂，这两家工厂为威讯联合半导体集团内部提供自用半导体封装测试服务。目标公司的最终控制人为威讯联合半导体，主要业务为无线、有线和电源市场技术和产品的开发和商业化。 |
| 简易案件理由（可以单选，也可以多选） | 🗹 1、在同一相关市场，所有参与集中的经营者所占市场份额之和小于15%。 |
| 🞎 2、存在上下游关系的参与集中的经营者，在上下游市场所占的市场份额均小于25%。 |
| 🞎 3、不在同一相关市场、也不存在上下游关系的参与集中的经营者，在与交易有关的每个市场所占的份额均小于25%。 |
| 🞎 4、参与集中的经营者在中国境外设立合营企业，合营企业不在中国境内从事经济活动。 |
| 🞎 5、参与集中的经营者收购境外企业股权或资产的，该境外企业不在中国境内从事经济活动。 |
| 🞎 6、由两个以上的经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中一个或一个以上经营者控制。 |
| 备注 | **横向重叠：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **相关产品市场** | **相关地域市场** | **2022年市场份额** |
| 半导体委外封装测试服务 | 全球市场 | 立讯精密：0-5%；目标公司：0-5%；双方合计：5-10% |
| 中国境内市场 | 立讯精密：0-5%；目标公司：0-5%；双方合计：5-10% |

 |